

高機能エポキシ系接着剤「f・Stick」シリーズ

2024 マイクロエレクトロニクスショー出展のお知らせ

2024年6月12日(水)～14日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「2024マイクロエレクトロニクスショー」に、当社の高機能エポキシ系接着剤「f・Stick」シリーズを出展いたします。

当社は、お客様のご要望に合わせた、高機能エポキシ系接着剤の受託開発及び製造供給を行っております。本展示会では、「低温・短時間硬化の接着剤」や「高密着型軟質接着剤」などのラインナップを揃えてお待ちしておりますので、是非とも当社ブースにお立ち寄りください。

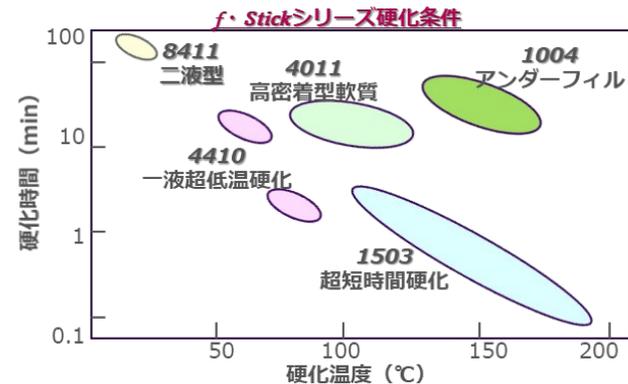
開催期間： 2024年6月12日（水）～6月14日（金）

会場： 東京国際展示場（東京ビッグサイト）東展示棟
・ 出展ゾーン： eX-tech
・ 小間番号： 3B-21

公式サイト： <https://www.jpccashow.com/show2024/index.html>

■ 出展材料

低温超短時間硬化接着剤	50℃/20分 or 80℃/2分で完全硬化、カーボンニュートラル、低応力接合に絶大な効果
高密着型軟質接着剤	シリコン並の柔らかさで、エポキシ並の高密着強度を両立
超短時間硬化接着剤	わずか3秒（190℃）で、驚異的な短時間で接着/接合可能
接着剤補強型Sn-Biはんだペースト	180℃以下の低温リフロー接合可能で、Sn-Ag-Cuはんだと同等以上の特性



※当社ホームページでも「f・Stick」シリーズをご紹介します。詳細は「[こちら](#)」から